

Cadence Sigrity 相关产品

产品名称	主要功能及特点	用途
Sigrity PowerSI	先进的信号完整性、电源完整性及 EMI 解决方案。支持整个 IC 封装和 PCB 设计的 S-参数模型提取以及强大的频域仿真功能。	通用频域工具,可以进行 SI、PI、EMC 仿真分析
Sigrity PowerDC	IC 封装及 PCB 设计的高效 DC 解决方案。支持电、热协同仿真,最大限度的提高准确度。迅速且精确的定位 IR Drop 和当前的发热点。自动搜寻最好的遥感位置。	电热协同分析工具
Sigrity OptimizePI	自动化 PCB 及 IC 封装的 AC 频域解决方案。支持前布局和后去耦方案,确定阻抗问题,支持建议 EMI 去耦电容摆放位置。优化的基于性能或成本以及其他的去耦方案。	电容优化方案,基于性能、成本、面积等优化
Sigrity SPEED2000	完整的 PCB 和 IC 封装布局基于时域 EMI 的信号完整性仿真工具,同时支持电源完整性和 EMI 分析。能够用于高效准确的对布局设计进行检查和调试。	通用时域工具,可以进行 SI、PI、EMC 仿真分析
Sigrity SystemSI	针对高速芯片到芯片的全面及自动化信号完整性系统设计,准确的仿真评估环境。以确保并行总线,串行链路的接口的可靠实现。	专用高速串、并行总线仿真分析
Sigrity Broadband Spice	S 参数检查、调整及提取的组合工具,能够转换 N 端口网络参数,用以等效 SPICE 的兼容电路进行时域分析。	SPICE 模型转换工具,S 参数转 Spice
Sigrity T2B	高效的晶体管级别的模型转换工具,可以创建 SSO 及其到类型的精准模型。其模型的运行速度比用原来的晶体管级模型提高一个数量级。	Spice 模型转 IBIS 模型工具
Sigrity XtractIM	高效快速的 IC 封装 RLC 提取和评估解决方案,有选项来生成高精度的宽带模式。支持范围广泛的封装类型,包括 BGA、SIP 及 LEADFRAME 设计。	用于芯片封装的模型抽取的工具
Sigrity OrbitIO Planner	协同设计解决方案,加速 Prototyping and Pad Ring Planning in Single/Multi-Die 封装规划。支持 Flip-Chip、WireBond 及 RDL 工艺,并且行业标准数据内嵌在 IC、封装及 PCB 中。	IC IO 管脚规划
Sigrity XcitePI	完整的芯片电源完整性解决方案,针对芯片、系统协同仿真。支持早期的芯片的电源规划,I/O 和核心驱动模型提取,支持时域及频域仿真。	IC 电源完整性仿真工具

信息直接放在工程师的眼前，更重要的是，这些工程师往往会从中选择所需要的产品。如果供应商加入 Active Parts Portal，那么他们就可以与最终用户进行直接交流。设计师也能够方便从中了解到所需元件的最新信息，这样也可以使设计师更快速更准确的调用符合设计要求的元件。

联系方式：

科通数字技术有限公司

总部：深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

产品经理：王其平

手机：18049720018

邮件：QipingWang@comtech.com.cn

地址：上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04 室

华东地区

联系人：陈敏敏

手机：18017922811

邮件：PeterChen@comtech.com.cn

地址：上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04 室

华南及西部地区

联系人：谭波涛

手机：15920086575

邮件：terrytan@comtech.com.cn

地址：深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

华北地区

联系人：党建成

手机：18010161381

邮件：SudyDang@comtech.com.cn

地址：北京市海淀区中关村大街 1 号海龙大厦 14 层北区 1418-21